

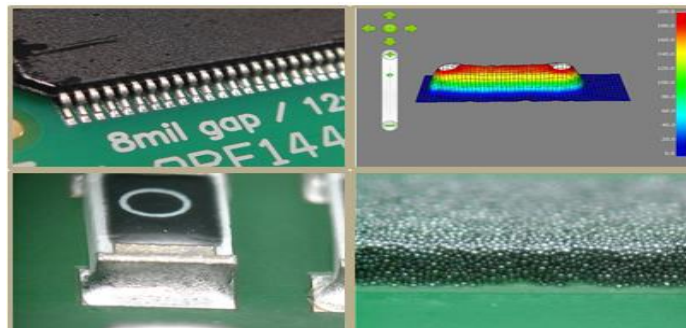
RMA258-15R SOLDADURA EN PASTA

CARACTERÍSTICAS

- Excelente Desempeño en la Impresión con Largas Pausas
- Excelente humectación. Incluso en dispositivos sin plomo.
- Excelente Definición en la Impresión
- Desempeño Superior en Perfiles de Reflujo Largos y Calientes
- ROL0 por IPC J-STD-004
- Reduce Vacíos

DESCRIPCIÓN

La soldadura en pasta RMA258-15R de AIM con base de resina ha sido desarrollado para la manufactura de productos electrónicos de alta confiabilidad y de clase militar. La soldadura en pasta RMA258-15R ofrece excelente desempeño en procesos de impresión con largas pausas, incluso en dispositivos miniaturizados. Su fórmula reduce la generación de vacíos en componentes BGA / BTC y elimina el defecto de Hip o cabeza-en-almohada. Sus potentes activadores generan uniones de soldadura suaves, lisas y brillantes. La fórmula de la soldadura en pasta RMA258-15R es capaz de soportar perfiles de reflujo largos y calientes comunes a los ensamblajes de potencia y de alta masa térmica. Los residuos pueden ser removidos por sistemas convencionales de limpieza a vapor para la eliminación de vapor, lavadoras con agua o químicos de limpieza.

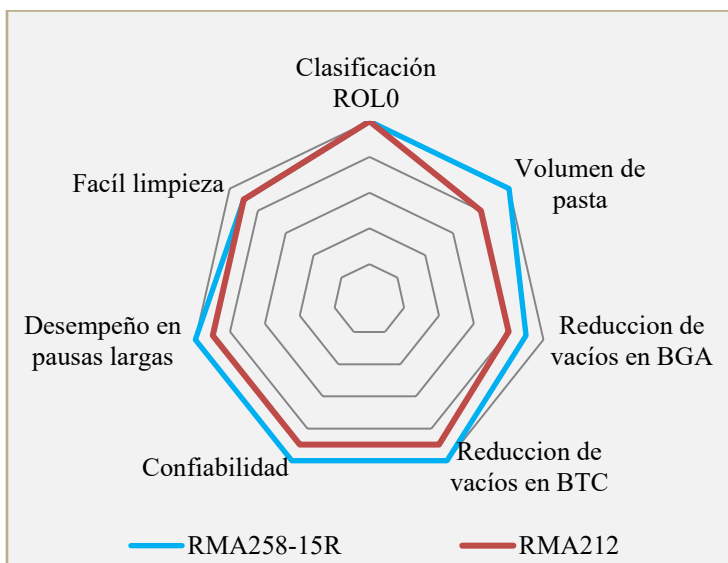


MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Aleación	Parámetro	Tiempo	Temperatura
Libre de Plomo	Vida útil de pasta sellada y refrigerada	1 año	0°C-12°C (32°F-55°F)
Libre de Plomo	Vida útil de pasta sellada no refrigerada	6 Meses	< 25°C (< 77°F)
Con Plomo	Vida útil de pasta sellada y refrigerada	9 Meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Con Plomo	Vida útil de pasta sellada no refrigerada	4 Meses	< 25°C (< 77°F)

No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de RMA258-15R para información específica del producto.

CARACTERÍSTICAS



LIMPIEZA

Pre-reflujo: El limpiador de estenciles de AIM elimina eficazmente la soldadura en pasta de los estenciles durante el proceso. El limpiador de estenciles se puede aplicar a mano o utilizar en equipos de limpieza bajo estencil. El limpiador de estenciles no seca la soldadura en pasta y mejora las propiedades de transferencia. No aplique una cantidad excesiva de limpiador de estenciles. No aplique el limpiador de estenciles en la parte superior del estencil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) durante el proceso, pero se puede utilizar como enjuague final del estencil.

Residuos de flux posteriores al reflujo: Pueden quedar residuos en el ensamblaje después del reflujo, pero no es necesario limpiarlos. Cuando la limpieza es obligatoria, AIM ha colaborado estrechamente con socios del sector para garantizar que los residuos se puedan eliminar eficazmente con agentes desfluxantes comunes. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre la limpieza.

PERFIL DE REFLUJO

Toda la información del perfil se puede encontrar en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Póngase en contacto con AIM para obtener información adicional.

IMPRESIÓN

Configuración Inicial Recomendada - Varía de acuerdo al tipo y diseño del PCB o pad	
Parámetro	Valor Inicial Recomendado
Presión de la espátula	0.9 -1.5 libra/pulgada de navaja
Velocidad de la espátula	0.5 - 6 pulgada/segundo
Distancia de Separación (Snap-off)	En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y estencil	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y estencil	3 - 20 mm/Segundo

DATOS DE PRUEBA

Nombre	Método de Prueba	Resultado	
Clasificación de IPC flux	J-STD-004 versión actual	ROL0	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Flux.	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros	
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Contenido de Sólidos No Volátiles en el Flux	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	95.7% Típico	
Índice de Acidez del Flux	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	133 mg KOH/ g flux Típico	
Determinación de la gravedad específica del flux	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	3.68 Típico	

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	Fórmulas para Dispensado e Impresión disponibles	
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa	
Prueba colapsa miento de la Soldadura en Pasta (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	48.8 g Típico	
Prueba de Mojado (Wetting)	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA	